

# サーモスター/低硬度タイプ Thermostar/Low hardness

## TMS-US18 series



### 特長

### Features

- ▶ 低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。
  - ▶ シロキサン含有量を低減。
  - ▶ 熱源の形状に合わせてカッティング納品が可能です。
- The low hardness, and a wide range of clearance, to reduce the burden on the substrate.  
Low siloxane content.  
The sheet can be cut to the shape of the heat source before shipment.



E322053

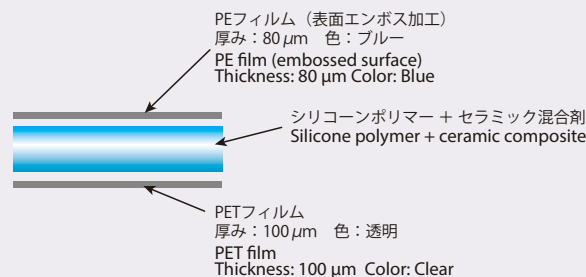
### 用途

### Applications

- ▶ CPU、ICの放熱対策。
  - ▶ パワー IC の熱対策。
  - ▶ スイッチング電源の熱対策。
  - ▶ その他、さまざまな熱源に対応します。
- Heat dissipation of CPU and IC.  
Heat management of power IC.  
Heat management for switching power supply.  
Various other heat sources.

### 構造

### Structure



### 品番表

### Product list

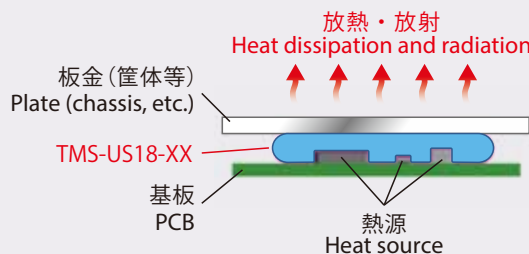
[単位 Unit:mm]

品番 Product code	厚み Thickness	定尺 Fixed sizes	
		幅 Width	長さ Length
TMS-US-18-10	1.0±0.2	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-15	1.5±0.2	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-20	2.0±0.3	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-30	3.0±0.3	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-40	4.0±0.3	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-50	5.0±0.4	300 +5/-0	300 +5/-0
TMS-US-18-60	6.0±0.5	300 +5/-0	300 +5/-0

※製品厚み寸法は PE・PET フィルムを除いた寸法値です。  
\* Product thickness excludes PE and PET films.

### 使用例

### Application examples



### 一般特性

### General characteristics

項目 Item	TMS-US18
外観色 Appearance (color)	ライトブルー Light blue
密度 (g/cm <sup>3</sup> ) Density (g/cm <sup>3</sup> )	2.7
熱伝導率 (W/m・k) Thermal conductivity (W/m・k)	QTM-500 *1 1.8 TCM1001 *2 2.3
硬度 (アスカ-C) Hardness (Asker C)	9
体積抵抗率 (Ω・cm) Volume resistivity (Ω-cm)	10 <sup>12</sup>
引張強度 (MPa) Tensile strength (MPa)	0.08
使用温度範囲 (°C) Operating temperature range (°C)	-40~160 -40 to 160

\*1 京都電子工業㈱製 QTM-500 迅速熱伝導率計による測定値。  
\*2 ㈱レス力製 TCM1001 熱伝導率測定装置による、□20mm、加圧 20N、厚み 2mm 時の測定値。  
\*1 Measurement with Kyoto Electronics Manufacturing's QTM-500 quick thermal conductivity meter.  
\*2 Measured with a TCM1001 thermal conductivity measuring device manufactured by RHESCA Co., LTD. at 20 mm square, 20 N applied pressure, and 2 mm thickness.